

Kemet ラッピング&ポリッシングプレート

KemetプレートとはLED基盤などの半導体材料や金型、ガラス、その他各種難削材のラップ・ポリッシュに最適な特殊樹脂混合プレートです！



ケメットプレートの特徴

1. ケメットプレートは、樹脂と金属の混合材のため、弾性を持ち、ダイヤモンドワークの接触時にショックを吸収して加工面に損傷を与えません。
2. 弾性があるのでダイヤモンドを一律に保持できます。この砥粒保持力により、ダイヤモンドは均一に固定され、正しく半固定砥粒として研磨能力を発揮します。
3. 研磨装置のフェーシング機構、または電着リングとの組み合わせにより、簡易かつ正確に平坦度の管理が可能。
4. 端面のダレを許されない平坦加工に広く活用可能。
5. 素材とラップ目的に合った最適なプレートを選択でき、用途、ニーズに合わせたプレートを選定、製造可能。

プレートサイズ

(径) $\phi 6'' \sim$ 最大径はご相談下さい。
 $\phi 48''$ 以上の場合はセグメントでご対応。
(厚み) 標準厚み $1/2'' (12\text{mm})$ or $1/4'' (6\text{mm})$
特注サイズ可能。
プレートの貼付け・形状加工・溝入れ加工も当社で実施できます。

代表的なケメットプレート

◆ケメットメタル樹脂プレート

鉄、銅、銅XP、錫 他

◆ケメットアルミナ樹脂プレート

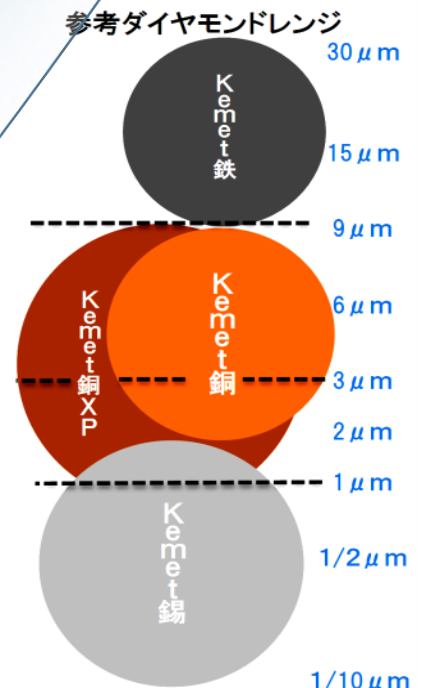
高純度アルミナ混合、金属コンタミレス仕様

◆ケメットピュアレジンプレート

ガラス材に最適なレジンプレート、金属コンタミレス

◆ピュアメタルプレート

鋳鉄、メタル銅、メタル錫



Kemet

ケメット・ジャパン株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6
WBGマリブウエスト21階

TEL : 043-213-9911

FAX : 043-213-9932

MAIL : info@kemet.jp